日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-247952

[ST.10/C]:

[JP2002-247952]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社日立製作所

U.S. Appln Filed 8-20-53 Inventor: S. Kanno et al mattingly Stanger & malur Docket ASA-1145

2003年 5月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-247952

【書類名】

特許願

【整理番号】

1101025391

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

B01D 53/86

【発明の名称】

パーフルオロコンパウンド分解方法、分解触媒及び処理

装置

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目2番1号

株式会社 日立製作所 電力・電機開発研究所内

【氏名】

菅野 周一

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

株式会社 日立製作所内

【氏名】

玉田 慎

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目2番1号

株式会社 日立製作所 電力・電機開発研究所内

【氏名】

市川 伸一

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目2番1号

株式会社 日立製作所 電力・電機開発研究所内

【氏名】

河崎 照文

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県日立市大みか町七丁目2番1号

株式会社 日立製作所 電力·電機開発研究所内

【氏名】

山下 寿生

【特許出願人】

【識別番号】

000005108

特2002-247952

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】

100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】

作田 康夫

【電話番号】

03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013088

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パーフルオロコンパウンド分解方法,分解触媒及び処理装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ハロゲンとしてフッ素のみを含有するパーフルオロコンパウンドが含まれているガス流を、水蒸気または水蒸気と酸素の存在下で、500~800℃の温度で、NiとWとA1を触媒活性成分とし、NiとA1よりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物を含む触媒と接触させて前記パーフルオロコンパウンド中のフッ素をフッ化水素に転化することを特徴とするパーフルオロコンパウンド分解方法。

【請求項2】

請求項1おいて、前記触媒はNi/A1のモル比が $5/95\sim40/60$ よりなり、NiとA1の重量に対し $We 0.1 \sim 10$ 重量%含むことを特徴とするパーフルオロコンパウンド分解方法。

【請求項3】

ハロゲンとしてフッ素のみを含有するパーフルオロコンパウンドを水蒸気または水蒸気及び酸素と反応させて分解するための触媒であって、NiとAlとWを 触媒活性成分とし、NiとAlよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化 物を含むことを特徴とするパーフルオロコンパウンド分解触媒。

【請求項4】

請求項3において、前記触媒はNi/Alのモル比が5/95~40/60よりなり、NiとAlの重量に対しWを0.1 ~10重量%含むことを特徴とするパーフルオロコンパウンド分解触媒。

【請求項5】

アルミニウム原料の粉末にニッケル原料を含む水溶液を添加したのち焼成し、 その後、タングステン原料を含む水溶液を添加して焼成することにより、Niと Alよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物を含む触媒を得ることを 特徴とするパーフルオロコンパウンド分解触媒の調製方法。

【請求項6】

パーフルオロコンパウンドを窒素または空気により希釈したガス流を得る手段と、前記ガス流に水蒸気を添加する手段と、水蒸気が添加された前記ガス流を触媒に接触させてパーフルオロコンパウンドを分解するための反応器と、前記反応器に充填されたNiとAlとWを触媒活性成分としNiとAlよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物を含む触媒と、前記触媒をパーフルオロコンパウンドの分解温度に加熱するための加熱手段と、前記反応器内にて生成した分解生成物を含むガスを水またはアルカリと接触させてガス流中からフッ化水素を除去する排ガス洗浄槽とを具備したことを特徴とするパーフルオロコンパウンド処理装置。

【請求項7】

半導体または液晶のエッチング装置の後段に請求項6記載のパーフルオロコンパウンド処理装置を設置してエッチングガスを処理するようにしたことを特徴とするエッチングガス処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、 CF_4 或いは C_2F_6 などのようにハロゲンとしてフッ素のみを含有するハロゲン化合物を分解するパーフルオロコンパウンド処理方法とそれに使用する触媒,触媒調製方法及び処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

ハロゲンとしてフッ素のみを含有するハロゲン化合物はパーフルオロコンパウンド(以下、PFCという)と称され、半導体或いは液晶のエッチング剤、半導体洗浄剤等に使用されている。PFCは地球の温暖化物質であることから、その分解方法がいろいろと検討されている。PFC分解方法の1つに触媒を用いる方法があり、特開平10-192653号公報、特開平11-70322号公報及び特開平11-244656号公報等に記載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、PFCを触媒により分解する方法において、低温での活性を 高めることにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明は、NiとAlとWを活性成分とする触媒を用いてPFCを分解することにある。

[0005]

本発明の触媒は、触媒活性成分が最終的に酸化物の形で含まれる。また、少なくともNiとAlよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物が含まれる。NiとAlよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物以外にNiO,WO3,Al2O3のように単一の元素による酸化物或いはAlとWよりなる複合酸化物が含まれていても良い。

[0006]

NiとAlよりなる複合酸化物は、スピネル型の複合酸化物よりなるか或いはスピネル型の複合酸化物を含むことが望ましい。スピネル型の複合酸化物はNiAl $_2$ O $_4$ よりなることが望ましい。また、NiとWよりなる複合酸化物はNiWO $_4$ よりなるか或いはそれを含むことが望ましい。

[0007]

本発明の触媒の活性成分はNiとAlとWよりなる。但し、本発明の目的を損なわなければこれら3成分以外に他の成分が若干含まれることを否定するものではない。触媒活性成分における各元素の量は、Ni/Alのモル比にて5/95~40/60よりなることが望ましく、特に15/85~30/70よりなることが望ましい。Ni/Alのモル比が5/95は、重量%に換算するとNiが5.6 重量%、残りがAlになる。また、Ni/Alのモル比が40/60は、重量%に換算するとNiが38.8 重量%、残りがAlになる。同様にNi/Alのモル比が15/85は、重量%に換算するとNiが16.1 重量%、残りがAlになる。Ni/Alのモル比が30/70は、重量%に換算するとNiが30.3 重量%、残りがAlになる。Ni/Alのモル比が30/70は、重量%に換算するとNiが30.3 重量%、残りがAlになる。Ni/Alの比率が前記した範囲内のときに高いPFC分解率が得られるようになる。NiとAlの比率が前述の範囲にあ

るものにWを $0.1 \sim 10$ 重量%望ましくは $1 \sim 5$ 重量%の範囲で添加することにより、低温側でのPFC分解率を高めることができる。

[0008]

NiとAlよりなる触媒にWを添加することにより低温でのPFC分解率が高くなる理由は明らかではないが、Wの添加により H_2 O が解離活性化しやすくなり、またWとNiとが複合酸化物を形成することによりニッケル表面上のPFCへ活性化した H_2 O をスムーズに供給できるためではないかと推察される。つまり、WはNiAl $_2$ O $_4$ 等の複合酸化物粒子の近傍にNiとの複合酸化物として存在し、水蒸気を解離活性化してPFC分解反応を活発にしているものと推察される。

[0009]

本発明で対象とするPFCは、ハロゲンとしてフッ素のみを含有する化合物であり、炭素とフッ素からなる化合物、炭素と水素とフッ素からなる化合物、炭素とフッ素と酸素からなる化合物、炭素とフッ素と酸素からなる化合物、硫黄とフッ素と酸素からなる化合物、窒素とフッ素からなる化合物、窒素とフッ素と酸素からなる化合物等である。一例をあげるとCF4、CHF3、CH2F2、CH3F、C2F6、C2HF5、C2HF5、C2H2F4、C2H3F3、C2H4F2、C2H5F、C3F8、CH3OCF2CF3、C4F8、C5F8、SF6、SO2F2、NF3等がある。

[0010]

本発明のPFC分解方法では、主として以下の反応式によって分解がすすむものと考えられる。PFCの分解反応は加水反応であり、PFCの分解によってフッ化水素HFが生成する。このほかの分解生成物は、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物等である。一酸化炭素が生成した場合、本発明の触媒には一酸化炭素酸化作用があるので、ガス流中に一酸化炭素を分解するのに十分な量の酸素が存在していれば、反応器内において一酸化炭素を二酸化炭素に変換することができる。

[0011]

【式1】

$$CF_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4HF$$
 $C_2F_6 + 3H_2O \rightarrow CO + CO_2 + 6HF$
 $CHF_3 + H_2O \rightarrow CO + 3HF$
 $SF_6 + 3H_2O \rightarrow SO_3 + 6HF$
 $NF_3 + 3/2H_2O \rightarrow NO + 1/2O_2 + 3HF$

本発明では、PFCを分解するために水蒸気がいる。PFCをHFに転化するには、最低でも処理ガス中のF数と同等の水素分子を含む必要がある。通常、水蒸気は理論水蒸気必要量の数十倍含まれているが、本発明ではW添加により反応ガス中の水蒸気が活性化されやすくなっているため、水蒸気の量を減らしても高い分解率が得られる。本発明では、水蒸気量は理論水蒸気必要量の3~20倍もあれば十分であり、5~10倍程度でもよい。

[0012]

反応温度は500~800℃が好ましい。反応温度が500℃以下では本発明といえども高いPFC分解率が得られない。550℃以上の反応温度であれば、本発明の触媒は極めて高いPFC分解活性を示す。PFCの濃度が3~5%のように高い場合には、反応温度は高めにするのがよい。PFCの濃度が1%以下のように低い場合には反応温度を低めにしてもよい。反応温度を低くすることにより、触媒の劣化を抑制でき、また、処理装置の材料の腐食を進みにくくすることができる。

[0013]

本発明では、PFC分解反応によって生成したHFを除去するために、反応器から排出されたガスを水またはアルカリに接触させることが望ましい。PFCの分解生成物を水またはアルカリに接触させる方法としては、水またはアルカリ水溶液中に分解生成ガスをバブリングする方法、水またはアルカリ水溶液を分解生成ガスにスプレーする方法等が適用可能であり、充填塔を用いて洗浄する方法でもよく、またアルカリ水溶液ではなくアルカリ性の固体を用いてもよい。

[0014]

本発明の触媒を調製するにあたってのA1原料としては、 γ -アルミナ, γ -アルミナと δ -アルミナの混合物などを使用することができる。特にベーマイト

をA1原料として用いて最終的な焼成により酸化物を形成させるのは非常に好ま しい。

[0015]

Ni原料或いはW原料には、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩、塩化物等を用いることができる。

[0016]

触媒の製造法は、触媒の製造に通常用いられる沈殿法、含浸法、混練法等を適用できる。アルミニウム原料の粉末にニッケル原料を含む水溶液を添加したのち焼成し、その後、タングステン原料を含む水溶液を添加して焼成し、これによってNiとAlよりなる複合酸化物とNiとWよりなる複合酸化物を含む触媒を製造する方法は、非常に好ましい触媒調製方法である。

[0017]

触媒の最終形状は、粒状でもよいし、ハニカム状などに成形してもよい。触媒成形法としては、押し出し成形法,打錠成形法,転動造粒法など任意の方法を採用できる。また、セラミックス製或いは金属製のハニカムや板に触媒成分をコーティングして使用してもよい。

[0018]

本発明のPFC処理装置は、PFCを窒素または空気により希釈したガス流を得る手段と、このガス流に水蒸気を添加する手段と、水蒸気が添加されたガス流を触媒に接触させるための反応器と、反応器内の触媒をPFC分解温度に加熱するための加熱手段と、反応器にて生成した分解生成物を含むガスを水またはアルカリと接触させてHFを除去する排ガス洗浄槽とを具備する。排ガス洗浄槽の後段に洗浄により中和されなかった一酸化炭素、窒素酸化物(NO,NO2等),硫黄酸化物(SO2,SO3等)等を吸着剤によって除去するための吸着手段を設置することは望ましい。

[0019]

本発明の処理方法を実施するに当たっては、処理するガス流中のPFC濃度を 最大でも5%以下、通常であれば1~2%程度にすることが望ましい。PFC濃度が高いと処理ガスを流す配管、反応器等が腐蝕劣化しやすい。PFC濃度を前 記範囲にするために、PFCを窒素或いは空気により希釈することが望ましい。

[0020]

反応器は、通常の固定床、移動床或いは流動床型のものでよいが、分解生成ガスとしてHF等の腐食性のガスが発生するので、これらの腐食性のガスによって損傷しにくい材料で反応器を構成すべきである。

[0021]

処理されるガス流中に固形物が含まれていたり或いは反応器内でH₂O と反応して固形物を生成する成分等が含まれている場合には、湿式スクラバー等の標準的な固形物除去装置を反応器の前段に設置するなどしてこれらを予め除去し、これらが触媒表面に析出してPFCの分解活性を低下させるのを防止することが望ましい。

[0022]

既設の半導体工場のエッチング工程、液晶工場のエッチング工程へ本発明の PFC分解処理装置を備えることは好ましい。なお、エッチング工程から排出されるPFC含有ガス流には、エッチングで生成した不純物が含まれており、PFC分解に影響を及ぼすことが懸念されるので、反応器に入る手前で除去することが望ましい。また、半導体工場では一般に酸成分ガスを処理するための排ガス処理装置が備えられているので、これをPFC分解生成ガスの洗浄装置として利用し、この装置の前段に本発明の触媒を充填した反応器を設置することも可能である

[0023]

【発明の実施の形態】

(実施例1)

実施例1では、NiとAlよりなる触媒と、NiとAlとWよりなる触媒について、性能比較を行った結果を示す。

[0024]

触媒1

NiとAlよりなる触媒は次のようにして調製した。

[0025]

市販のベーマイト粉末(Pural SB1, CONDEA社製)を120で1時間乾燥した。この乾燥粉末200.88g に、硝酸ニッケル6水和物(和光純薬)210.86g を溶かした水溶液を添加し、混練した。混練後、約300でで約2時間乾燥し、700でで2時間焼成した。焼成物を粉砕,篩い分けして0.5~1mmの粒径とした。完成後の触媒の組成はモル(mol) 比でNi/Al=20/80であった。X線回折パターンを調べた結果、NiAl $_2$ O $_4$ とNiOのピークが確認され、これらの酸化物が含まれていることが確認された。Al $_2$ O $_3$ のピークは検出されないことからアモルファスとして含まれているものと推定される。

[0026]

触媒2

NiとAlとWよりなる触媒は次のようにして調製した。なお、Wの量は仕込み量でNiとAlの重量に対し金属として5重量%にした。

[0027]

触媒 1 で調製した N i と A 1 よりなる触媒 (以下、N i / A 1 触媒と記載する)を 120 で 1 h 乾燥した。乾燥後の N i / A 1 触媒 100.31 g に、タングステン酸アンモニウムパラ 5 水和物(approx. (N H_4) $_{10}$ W $_{12}$ O $_{41}$ ・5 H $_2$ O ,和光純薬)7.10 g を 30 %過酸化水素水(和光純薬)48.31 g に溶解した水溶液を添加し、含浸した。含浸後、120 で 2 h 乾燥し、750 で 2 h 焼成した。この触媒は、 X線回折パターンにより N i A 1_2 O $_4$ と N i Oの存在と、A 1_2 O $_3$ がアモルファスとして含まれていることが確認された。また、 X P S 分析チャートにより、 N i W O $_4$ が確認された。 X P S チャートでは W O $_3$ 或いは A 1_2 (W O $_4$) $_3$ と思われる酸化物も確認された。

[0028]

図1は、本実施例1で使用したラボスケールの小型処理装置の系統図を示す。本装置は、 N_2 ,空気, CF_4 及び H_2 Oの供給系,反応器1,排ガス洗浄槽4,ミストキャッチャ5を具備している。反応器1には内径48.0mm,外径38.2mm,長さ450.0mm の寸法のものを使用した。この反応器は内部に外径3mmのインコネル製の熱電対保護管を有している。反応器1には本発明によるPFC分解触媒2が充填されている。反応器内のPFC分解触媒が充填されていない上部

空間部は予熱層になっている。反応器1は電気炉3の内部に設置されている。電気炉はPFC分解触媒2を加熱する役目とPFCを含むガス流を予熱する役目をしている。

[0029]

窒素約743 ml/min, 空気約187 ml/min、及び CF_4 約4.44 ml/minを反応器前段で混合し反応器1 に導入した。ドライベースの CF_4 濃度(窒素,空気、及び CF_4 流量から算出)は約0.43%となる。空間速度(SV)は920~925 h $^{-1}$ である。 H_2 O は純水を約0.180 ml/minで反応器に上部から供給し、予熱層で気化させて供給した。反応器はインコネル600 製で、PFC分解触媒2 を約75 m1 充填した。

[0030]

反応器 1 を電気炉 3 で外側から加熱し、触媒の温度が所定温度となるように調節した。分解生成ガスは、水道水を入れた排ガス洗浄槽 4 へ導入し、HF等の酸性成分を吸収除去した。排ガス洗浄槽の後段にはミストキャッチャ 5 を設置し、ミストキャッチャを通過した後のガスを更に乾燥剤 6 を詰めた容器に通して水分を十分に除去してからC F $_4$ 濃度をT C D ガスクロマトグラフ分析計で測定した。C F $_4$ の分解率は次式で求めた。

[0031]

【式2】

…(式2)

[0032]

図2は、性能評価結果を示している。Ni/A1 触媒よりなる触媒1 の CF_4 分解率は604 $\mathbb C$ で80 %であった。これに対し、Ni/A1 触媒にW を添加した触媒2 の CF_4 分解率は603 $\mathbb C$ で96 %と極めて高かった。図2 から明らかなように、触媒2 は、低温側での分解率が触媒1 に比べて高く、低温での分解活性が優れている。触媒2 の500 $\mathbb C$ での分解率は、触媒1 の600 $\mathbb C$ での分解率

よりも高い。触媒2が触媒1にくらべて分解活性がすぐれているのは、W添加により水蒸気を解離活性化してPFCの分解反応を活発にしていることと、触媒調製時に用いた過酸化水素水が細孔径変化に寄与していること等によるものと考えられる。

[0033]

(実施例2)

実施例2では、実施例1に記載した触媒2のWの量を変化させて分解率を測定した。

[0034]

触媒3

Wを仕込み量でNiとAlの重量に対し金属として1重量%となるよう添加したNiとAlとWよりなる触媒を、以下の方法で調製した。

[0035]

[0036]

触媒4

Wを仕込み量でNi/Al重量に対し金属として2重量%添加したNiとAlとWよりなる触媒を、以下の方法で調製した。

[0037]

触媒1で調製したNi/Al触媒を120Cで1h乾燥した。乾燥後のNi/Al触媒100.08gに、タングステン酸アンモニウムパラ5水和物(approx. $(NH_4)_{10}W_{12}O_{41} \cdot 5H_2O$,和光純薬)2.842g を30%過酸化水素水(和光純薬)48.40gに溶解した水溶液を添加し、含浸した。含浸後、120Cで2h乾燥し、750Cで2h焼成した。

[0038]

[0039]

触媒5

Wを仕込み量でNi/Al重量に対し金属として3重量%添加したNiとAlとWよりなる触媒を次のようにして調製した。

[0040]

[0041]

触媒6

Wを仕込み量でNi/Al重量に対し金属として10重量%添加したNiとAlとWよりなる触媒を次のようにして調製した。

[0042]

触媒 1 で調製したN i / A 1 触媒を1 2 O $\mathbb C$ で 1 h 乾燥した。乾燥後のN i / A 1 触媒 1 O 0 . 4 2 g に、タングステン酸アンモニウムパラ 5 水和物(approx. $(NH_4)_{10}W_{12}O_{41} \cdot 5H_2O$,和光純薬)1 4 . 2 O g を 3 O %過酸化水素水(和光純薬)4 8 . 9 8 g に溶解した水溶液を添加し、含浸した。含浸後、1 2 O $\mathbb C$ で 2 h 乾燥し、7 5 O $\mathbb C$ で 2 h 焼成した。

[0043]

実施例1に示した触媒1と触媒2及び触媒3,4,5及び6について、 CF_4 の分解活性を実施例1のときと同じ方法で評価した。結果を図3に示す。

[0044]

Ni/A1 触媒に対してWを金属として $1\sim5$ 重量%添加した触媒は、650 \mathbb{C} , $600\mathbb{C}$ 及び $550\mathbb{C}$ の各反応温度での分解率がいずれもNi/A1 触媒よりも高く、低温での活性が優れていることが確認された。Ni/A1 触媒に対しWを金属として10 重量%含有した触媒は、 $550\mathbb{C}\sim700\mathbb{C}$ の反応温度での分解活性が触媒10Ni/A1 触媒の性能とほぼ同等であった。

[0045]

(実施例3)

本実施例 3 では、W原料を変えて以下に示す方法で触媒 7 と触媒 8 を調製し、CF $_4$ 分解活性を検討した。なお、いずれの場合もWの量は仕込み量でN i / A 1 重量に対し金属として 2 重量%とした。

[0046]

試験は、触媒層入口での CF_4 濃度を0.8%、 H_2O を当量比の $10\sim13$ 倍、 O_2 濃度を $1.0\sim1.2\%$ 、残部を N_2 とし、SVを約 $1350 h^{-1}$ とした。反応温度と分解率との関係を図4に示す。W原料及び溶媒を変えるとN i / A 1 触媒と分解性能はほぼ同じであった。

[0047]

触媒7

触媒1で調製したNi/A1 触媒を120Cで1h 乾燥した。乾燥後のNi/A1 触媒100.20 g に、メタタングステン溶液(日本無機化学工業株式会社製,MW-2) 2.792 g を純水41 g と混合し、この水溶液を含浸した。含浸後、120Cで2h 乾燥し、700Cで2h 焼成した。

[0048]

触媒8

触媒1で調製したNi/A1触媒を120℃で1h乾燥した。乾燥後のNi/A1触媒100.56g に、りんタングステン酸(和光純薬)2.851g を純水41gに溶解した水溶液を含浸した。含浸後、120℃で2h乾燥し、700℃で2h焼成した。

[0049]

(実施例4)

本実施例4では、触媒4の C_2 F_6 分解反応における H_2 O 量の影響を調べた。 比較のため同一条件で触媒1の性能も評価した。

[0050]

 C_2F_6 分解反応の理論式は、以下に示すとおりであり、 H_2O は C_2F_6 のモル数の3倍が必要となる。

[0051]

【式3】

 $C_2F_6 + 3H_2O \rightarrow CO + CO_2 + 6HF$

図 5 は、 H_2 O 当量比と C_2 F $_6$ 分解率との関係を示している。図中に丸印で示したデータは、触媒層入口での C_2 F $_6$ 濃度を1.0%、 O_2 濃度を1.00~1.2%、残部を N_2 とし、空間速度 S V を 1 100~1400 h^{-1} 、反応温度を750 Cとしたときのデータを示す。三角印で示したデータは、触媒層入口での C_2 F $_6$ 濃度を0.5%、 O_2 濃度を1.0~1.2%、残部を N_2 とし、空間速度 S V を 1 100~1400 h^{-1} 、反応温度を700 C2 したときのデータである。

[0052]

いずれの試験条件の場合でも、 H_2O 当量比が同じときには、NiEAlEW よりなる触媒の方が、NiEAlよりなる触媒に比べて C_2F_6 分解率が高い。これより本発明の触媒を使用すれば反応水量を低減できることが確認された。

[0053]

【発明の効果】

本発明によれば、 CF_4 , C_2F_6 などのハロゲンとしてフッ素のみを含有するパーフルオロコンパウンドの低温での分解活性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による処理装置の一実施例を示す概略図である。

【図2】

 CF_4 分解率と反応温度との関係を示す図である。

【図3】

 CF_4 の分解率とW量との関係を示す図である。

【図4】

 CF_4 の分解率と反応温度との関係を示す図である。

【図5】

 C_2F_6 の分解率と H_2O 当量比との関係を示す図である。

【図6】

本発明による触媒のX線回折パターンを示す図である。

【図7】

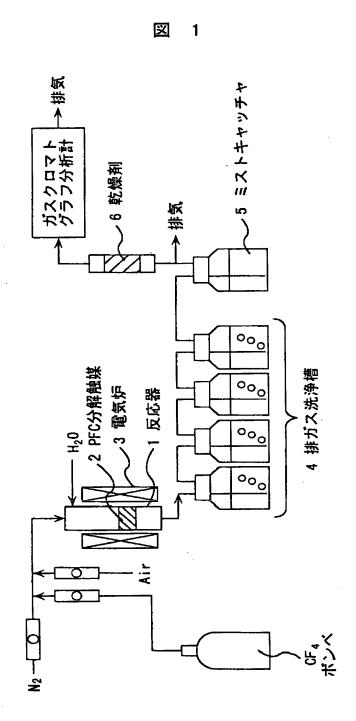
本発明による触媒のXPS分析チャートを示す図である。

【符号の説明】

1…反応器、2…PFC分解触媒、3…電気炉、4…排ガス洗浄槽、5…ミストキャッチャ、6…乾燥剤。

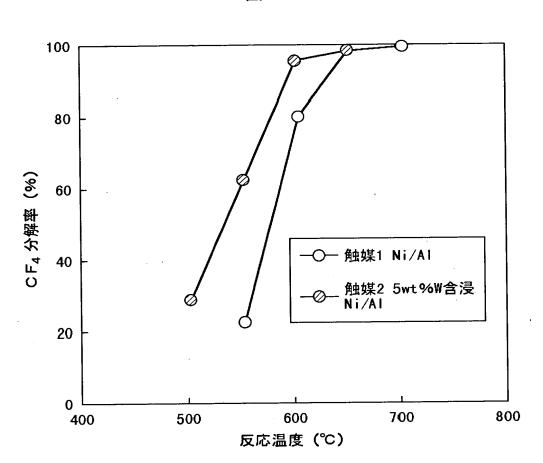
【書類名】 図面

【図1】



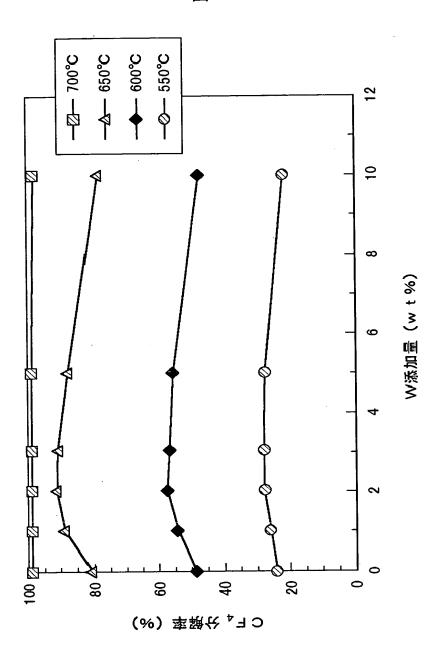
【図2】





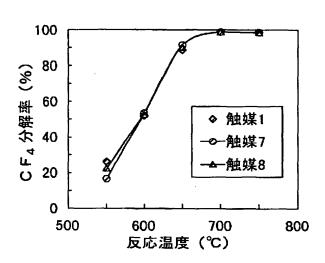
【図3】





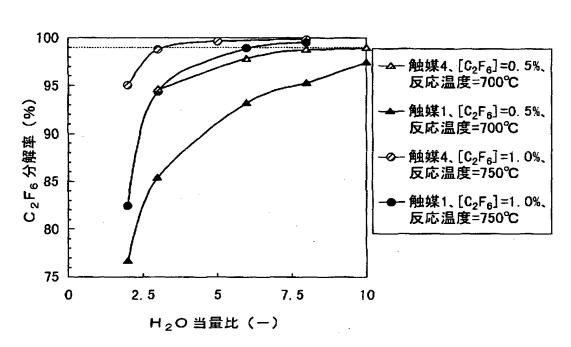
【図4】



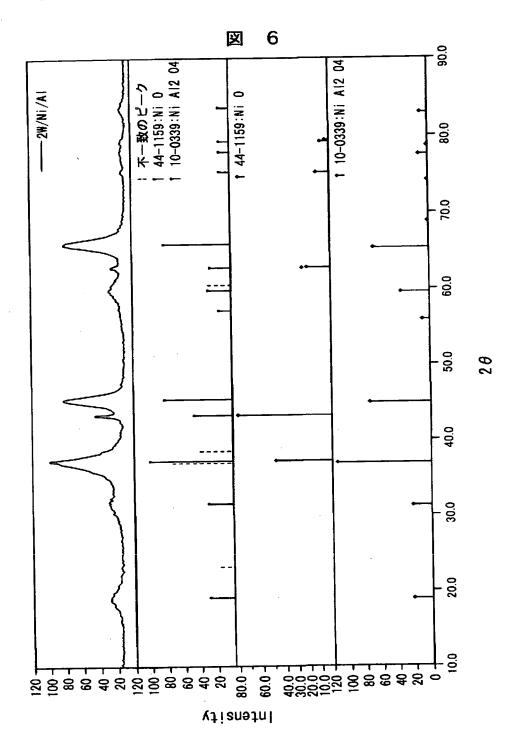


【図5】

図 5

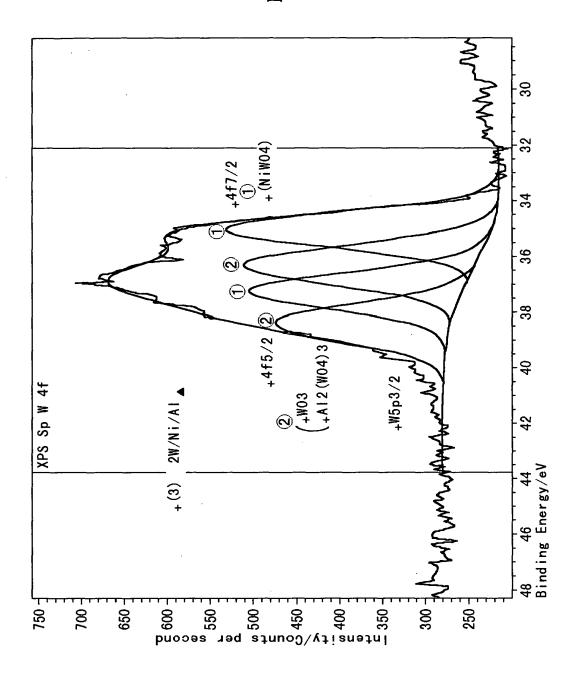


【図6】



【図7】

図 7



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

 CF_4 , C_2F_6 などのハロゲンとしてフッ素のみを含有するパーフルオロコンパウンドの低温での分解活性を高める。

【解決手段】

ハロゲンとしてフッ素のみを含有するパーフルオロコンパウンドを、水蒸気または水蒸気と酸素の存在下で、500~800℃の温度で、A1とNiとWを触媒活性成分とし、NiとA1よりなる複合酸化物と、WとNiよりなる複合酸化物を含む触媒と接触させてパーフルオロコンパウンド中のフッ素をフッ化水素に転化する。

本発明の触媒を使用することにより、低温での分解活性が高まり、パーフルオロコンパウンドを低温で高い分解率で分解できるようになる。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-247952

受付番号

50201273734

書類名

特許願

担当官

第六担当上席 0095

作成日

平成14年 8月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 8月28日

特2002-247952

出願人履歴情報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名

株式会社日立製作所